



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	-	2.64
A1	0.10	0.15	0.20
A2	2.24	2.34	2.44
b	0.39	-	0.47
b1	0.38	0.41	0.43
c	0.25	-	0.30
c1	0.24	0.25	0.26
D	12.65	12.75	12.85
Df	12.75	-	13.25
E	10.10	10.30	10.50
E1	7.40	7.50	7.60
e	1.27BSC		
L	0.71	0.86	1.01
L1	1.30	1.40	1.50
θ	0	-	8°
f	0.05	-	0.20

Note:

1. All dimension are in mm.
2. Dim D & E1 does not include plastic flash;  
Df includes plastic flash(f);  
Flash: Plastic residual around body edge after  
dejunk/singulation.
3. Dim b does not include dambar protrusion/intrusion.
4. Plating thickness 0.007mm-0.020mm



拟制		复审	
审核		会签	
制图		标准化	
幅面: A4		批准	
		比例: 1:1	

更改标记	更改内容	签 名	日 期
<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>永嘉微电 Vinka Microelectronics</div></div>			
VKXHSOP20V11_POD 产品外形图名称		图 号:VKXHSOP20V11_POD	
		单 位	版本
		mm	V1.1
		第 1 张	共 1 张
<div><div><div></div></div><div>-</div><div><div></div></div></div>			